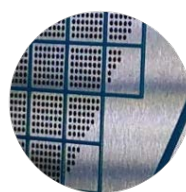


「第47回 インターネプコン ジャパン」出展のご案内

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、1月17日(水)～19日(金)に東京ビッグサイトで開催される題記展示会において、精密電鍍技術を活用したウェハバンピングサービスやメタルマスク、転写リードなどの製品を展示いたします。



1.名称 第47回インターネプコン ジャパン (主催:リード エグジビション ジャパン株式会社)
公式サイト:<http://www.nepcon.jp/>

2.会期 2018年1月17日(水)～1月19日(金) 10:00～18:00 ※19日(金)のみ 17:00 終了

3.会場 東京ビッグサイト(東京都江東区)／マクセルブース(東3ホール ブース番号:E27-31)

4.入場 5,000円 (公式サイトからの登録で、無料招待券を入手できます)

5.主な展示品

●ウェハバンピングサービス

自社開発した特殊構造治具により、均一性の高いソルダンプ形成が可能

●メタルマスク

微細加工が可能な電鍍技術により、 $\phi 50 \mu m$ 以下のソルダボール搭載や、特殊支柱形成により優れた搭載率を実現

●転写リード

シンプルかつ自由な設計で IC パッケージの小型化・薄型化が可能

●電鍍金型

1層構造から多層構造に対応し、ミクロン単位の位置合わせを実現

6.お問い合わせ先

マクセル株式会社 ライフソリューション事業本部 営業本部 アカウント営業部

TEL:03-6407-2927

皆様のご来場をお待ちしております。

以上